

台湾を軸にグローバル事業の再編を進める 三井ハイテック

瞬時に大量のICリードフレームやモーターコアを作り出す革新的な金型開発で世界をリードする三井ハイテック。台湾をグローバル事業再編の軸とし、台湾進出11年目を迎える今年から2013年にかけて、高雄輸出加工区にある工場の生産能力を大幅に高め、製品の多元化、高付加価値化を進めていく。競合メーカーが生産拠点を中国へ移す中、同社が台湾拠点の強化を選択した背景や戦略について、舟越知巳董事長に話を伺った。



台湾三井高科技(股)
舟越知巳董事長

台湾進出の経緯と事業概要について。

弊社は金型によるICリードフレームの先端技術を有しており、元々は台湾政府から請われる形で1999年に台湾に進出しました。赴任当時に上司から「先端技術を台湾に根付かせ、台湾の産業を振興することが我々の使命のひとつ」と言われたことを今でもよく覚えています。

台湾では、スタンピングによるICリードフレームの生産販売を行なっています。フレームの製造にはスタンピング(打ち抜き)とエッチングがあります。前者は金型を使って同規格のフレームを大量生産するのに適しており、後者は顧客ニーズに応じた特別仕様のフレーム作りに適しています。弊社の顧客である台湾のIC組立・テストの専門メーカー(サブコン)は汎用品を大量生産するので、フレームはスタンピングで作ります。現在、台湾リードフレーム市場における弊社のシェアは約10%(本社からの輸入品を含む)で第4位です。

今年秋から香港とフィリピンの生産設備を一部台湾へ移管します。グローバル再編の背景は？

金融危機によりIC供給先の自動車や家電が大打撃を受け、弊社も2008年10月から業績が急激に落ち込みました。グローバルな事業再編の話は元々あったのですが、不況を機に話が加速しました。受

注減で工場が止まっている今だからこそ、各地の設備を動かして生産体制の最適化を図ることができました。香港は、かつてはリードフレームの一大消費地だったのですが、去年は生産の8割が台湾向けの輸出という状況でした。フィリピンは1990年代の進出後に市場が思ったほど伸びず、両拠点の資源を台湾拠点に集約し、スケールメリットを出す道を選択しました。既存設備の集約ですので、少ない投資で、短期間で規模を拡大させられます。

事業拡大計画の目標と具体案は？

第1期工事(2009~10年)、第2期工事(2011~13年)を通じて、香港とフィリピンから輸出加工区内の新しい工場へプレス搬入し、めっきラインと(フレームの寸法を整える)焼鈍を敷設します。第2期工事を終えるころには、弊社の海外工場では最大のマレーシア工場と同規模の生産能力を備える見通しです。これにより、シンガポール、マレーシア、上海、台湾を中心とするアジア事業体制が確立されます。新工場の第2期工事を終える2013年の売り上げは、現在の3倍まで伸ばし、市場シェアは20%、第1位を目指します。従業員も順次増やしていき、2013年までに200人体制とする計画です。

シェア拡大には、製品構成の変化が必要です。現状は、大型で高度な技術を要するフレーム(QFP /

日本企業から見た台湾

TQFP / LQFPタイプ)に売上が偏っているので、売上比率の小さい小型で安価なフレーム(SO / SSOP、TSOPタイプ)の生産を強化し、製品の多軸化を図っていきます。また、スケールメリットを活かして、これまで取りこぼしてきた製品を取り込み、営業活動を活性化させていきます。

弊社では生産のほか、サブコンに対するIC組み立ての技術支援も行っています。作業工程で不具合が生じた時、たとえフレームに起因する訳ではないとしても、現場に出向いて、丁寧に指導します。今はこれを出張ベースで行っていますが、今後は本社のエンジニアに常駐してもらい、サポート体制を強化します。

また、製品の付加価値向上も今度の課題の一つです。今は日本で製造して中国に輸出している高度な技術を要するフレームを、将来的には台湾で作って中国へ輸出するようなモデルを作りたいですね。こうした構想は以前からありましたが、昨年未の三通開放が追い風となっています。三通と言うと中国から台湾への物流を想定しがちですが、もちろん逆だつてあるはず。台湾のポテンシャルは非常に大きい。ただしこれを実現するには、いいモノを低コストで大量生産するために拠点機能の強化が不可欠です。

競合メーカーは中国へ生産拠点を移しつつあるが、その中で台湾拠点を強化する狙いは？

一つには消費地立地原則からです。弊社の顧客は台湾のサブコンです。顧客にきめ細かいサービスを提供するには、やはり現地で生産する必要があります。台湾のサブコンは大陸にも拠点を持っていますが、ヘッドクォーターは台湾にあるので、受注側も台湾にしっかりした営業拠点が必要です。次に、ICが使われる電子機器は台湾の基幹産業であり、台湾ICリードフレーム市場は今後も安定的だと予測されるためです。また、弊社はグローバルシェアでは1~2位を競っていますが、台湾でのシェアはまだまだ小さく、伸びしろがあります。弊社は他社と違い、元々中国にも生産拠点がありますので、中国での供給サポートは現体制でも問題がない点も台湾の強化を選択した理由の一つです。

投資対象としての台湾の魅力は？

まずは市場があることです。台湾にはIC組立・テスト世界1位のASE以下、Amkor、SPILなど有力なサブコンが多数あります。そして、何と云っても人の質が高い。規律があり、道徳心が高く、生産現場でモノがなくなったり、ケンカが起こったりということはまずありません。現場レベルで言うと、「ルール(決められたこと)を守る」という姿勢があります。これは、いいモノを作ろうとするメーカーの従業員の最低条件です。例えば「薬品は1本ずつ入れる」といった細かい作業手順には、一つ一つ意味があります。こうしたルールが守られないと、品質にムラができるだけでなく、安全の問題が生じます。この点、弊社では台湾の操業開始以来、労働事故0が続いております。

実は本社でグローバル再編が検討された時、中国を強化すべきか台湾を強化すべきか、様々な意見があったのですが、最終的に台湾に決まった理由の一つが「人」でした。従業員の定着率が高く、現在いる70人もしっかり育っています。これは南部の人たちの気質なのかもしれませんが、おおらかで情に厚い。今後の事業拡大には、そんな彼らの力が必要です。

ありがとうございました。

台湾三井高科技基本データ

会社名	台湾三井高科技股份有限公司
設立時間	1999年
董事長	舟越知巳
資本金	NT2億元
社員数	76人
事業内容	ICリードフレーム製造、IC組み立て及び技術支援

出所)ヒヤリングよりNRI整理